

PRECISION ACCRETECH BLADE
RESIN BOND BLADES
封装材料用树脂刀片 PG 系列

 ACCRETECH
TOKYO SEIMITSU

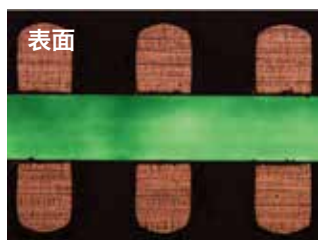


封装材料切割用树脂刀片。
实现了切割质量和耐磨损，长寿命的并存。



- QFN、DFN 等引线框架封装材料切割用树脂刀片系列
- 追求高速切割、长寿命、稳定的切割品质, 实现产品系列多样化

■加工例 树脂刀片 PG 系列



■ QFN 切割
 $n = 20,000 \text{ min}^{-1}$
 $f = 70 \text{ mm/sec}$

■ 高速切割条件下,
成功控制毛刺的发生。



规格和表示方法

1A8

形状

SDC

颗粒种类

230

目数

75

集中度

PG101

结合剂

颗粒种类

SDC 镀膜

生产范围

目数

170

200

230

270

325

集中度

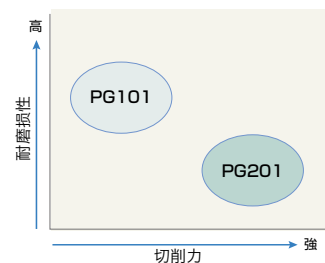
50, 75, 100

结合剂

PG101 长寿命

PG201 高品质

※有关新型结合剂PG102、PG202的问题，请另行咨询。



尺寸和表示方法

58D

0.2T

40H

外径

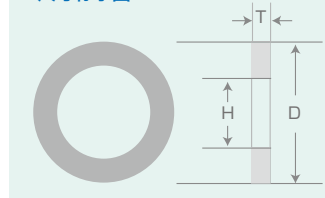
刃厚

内径

尺寸规格

外径(mm)		刃厚(mm)		内径(mm)
生产范围	公差	生产范围	公差	生产范围
50~62	+0.1 -0	0.17≤T≤0.35 0.35<T≤0.4	±0.01 ±0.02	40

尺寸标示图



生产范围

目数	厚度(mm)				
	0.17≤T ≤0.2	0.2<T ≤0.25	0.25<T ≤0.3	0.3<T ≤0.35	0.35<T ≤0.4
				●	●
				●	●
			●	●	
		●	●	●	
		●	●		

如有上述生产范围外的制作，请垂询商谈。

订购产品

订购我司产品时，请参考我司产品目录并告知以下详细信息。

- 1) 形状和尺寸 / 详细的刀片形状和精度要求等
- 2) 规格 / 希望我司提供的规格，以及现在贵司正在使用的刀片产品规格等
- 3) 切割的产品和切割的条件 / 使用设备，主轴转速，进刀速度，冷却条件等

注意事项

为了安全地使用刀片以及更好地发挥刀片的性能，请仔细阅读规格书及其他相关的产品信息。

- ※目录有可能未经通知而作修改
- ※该目录并非用于产品质量保证

株式会社東京精密

東精精密设备(上海)有限公司 上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路1077号凌阳大厦2101C室
邮编: 201203 TEL / +86-21-3887-0801 FAX / +86-21-3887-0805 <http://www.accretech.com.cn>

株式会社東京精密 東京営業所(代表) 〒192-0032 東京都八王子市石川町2968-2(東京精密八王子工場内)
TEL / +81-42-631-5211 FAX / +81-42-631-5234 <https://www.accretech.jp>